

高耐久鉛フリーソルダペースト

LSP シリーズ

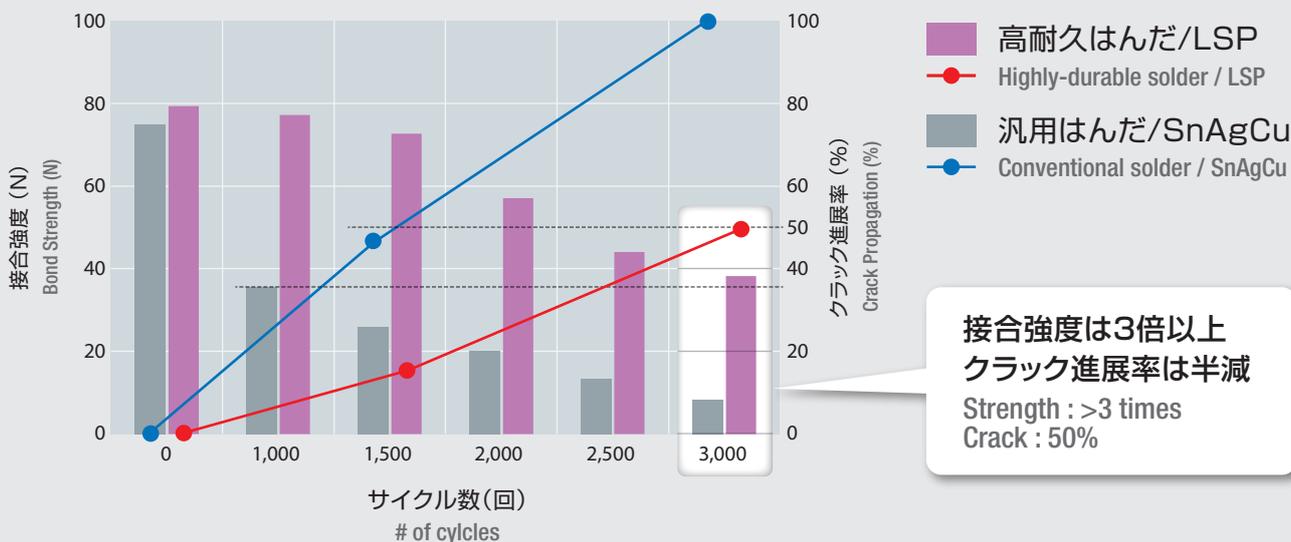
Highly-durable Lead-free Solder Paste / LSP

高耐久合金で過酷な使用環境下でも
信頼性の高いはんだ接合を実現します

Excellent durable alloy enables reliable solder joint with severe conditions.

耐久性評価 (冷熱サイクル試験: -40/+150°Cx3,000cycles)

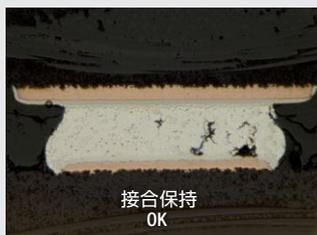
Durability Test (Thermal Cyclic Test)



接合強度は3倍以上
クラック進展率は半減
Strength : >3 times
Crack : 50%

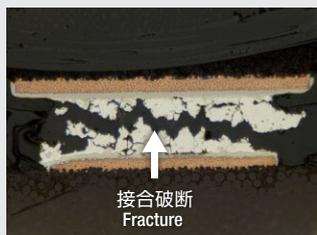
はんだ接合部断面観察 (冷熱サイクル試験後)

Cross-sectional Observation (After Thermal Cyclic Test)



接合保持
OK

高耐久はんだ / LSP
Highly-durable / LSP

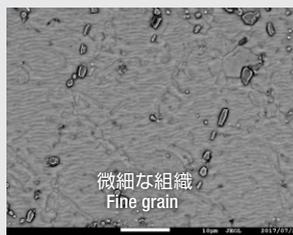


接合破断
Fracture

汎用はんだ / SnAgCu
Conventional / SnAgCu

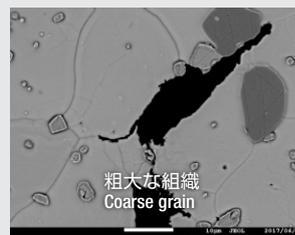
はんだ組織観察

Microstructure Observation



微細な組織
Fine grain

高耐久はんだ / LSP
Highly-durable / LSP



粗大な組織
Coarse grain

汎用はんだ / SnAgCu
Conventional / SnAgCu